MEPhI-VBLHE COLLABORATIVE WORKSHOP 2025











Статус ВВС SPD в МИФИ: Тесты и измерения

А. М. Захаров* НИЯУ МИФИ

Рентгеновский сканер

Координатный столик на основе рентгеновской трубки включает в себя:

• AMPTEK Mini-X X-ray tube

Ag мишень, $50 \text{ kV} / 75 \mu\text{A}$, 2 мм коллиматор (5° X-ray конус) на высоте ~ 3.5 мм от тайла

• NEMA 17 шаговый двигатель

Угловой шаг 1.8° , около 20 мкм разрешение (X и Y оси, механическое)

Arduino and CNC Sheild

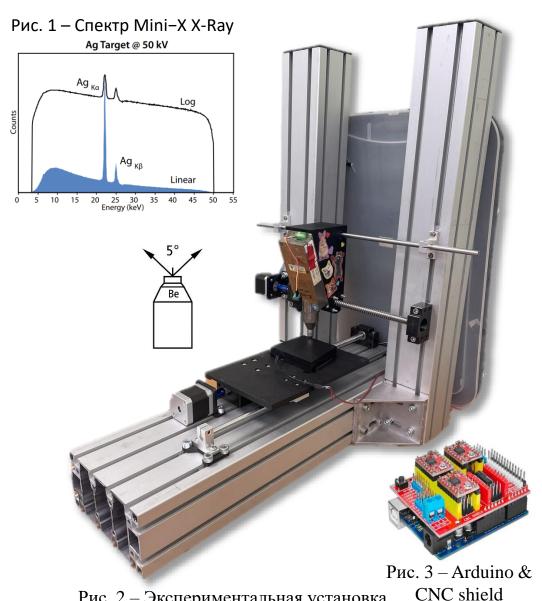
Микроконтроллерная плата ДЛЯ автоматизации движения

CAEN DT5202

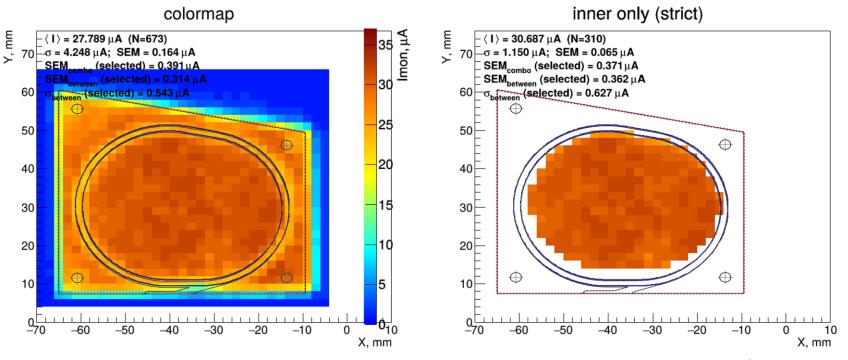
Источник питания A7585D с разрешением 1 мкA

Свинцовая защита

Светоизолирующий корпус



Программное обеспечение



outer in tile (strict) $\begin{array}{c}
(1) = 27.089 \,\mu\text{A} \,\,(\text{N=158}) \\
\sigma = 3.227 \,\mu\text{A}; \,\,\text{SEM} = 0.257 \,\mu\text{A} \\
\text{SEM}_{combo} \,\,(\text{selected}) = 0.415 \,\mu\text{A} \\
\text{SEM}_{between} \,\,(\text{selected}) = 0.184 \,\mu\text{A} \\
60 \,\,\text{Obtween} \,\,(\text{selected}) = 0.318 \,\mu\text{A}
\end{array}$

Рис. 1 – Пример программного обеспечения

- ➤ ПО примерным образом описывает «канавку» с волокном, и выделят интересующие нас регионы (ROI)
- ▶ В двух выделенных областях внешней и внутренней рассчитывается СКО, которое сигнализирует о скрытых дефектах и вносит вклад в итоговую погрешность

Метод 1: Механические дефекты

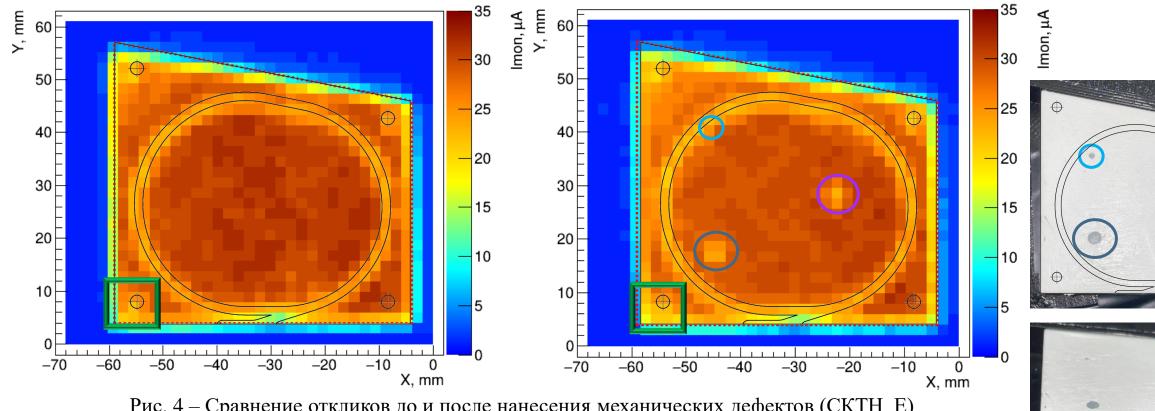


Рис. 4 – Сравнение откликов до и после нанесения механических дефектов (СКТН Е)

- > Отклик детектора также измерялся до и после нанесения дефектов (три отверстия диаметром 3 мм и одно отверстие 1 мм при одинаковой глубине 5 мм)
- > Стандартное отклонение в центральной области (внутри петли WLS) увеличивается с 1,15 мкА в образце без дефектов до 1,45 мкА после введения дефектов.
- ➤ Источник питания A7585D позволяет однозначно устанавливать факт наличия или отсутствия только крупных дефектов

Метод 2: Производственные дефекты

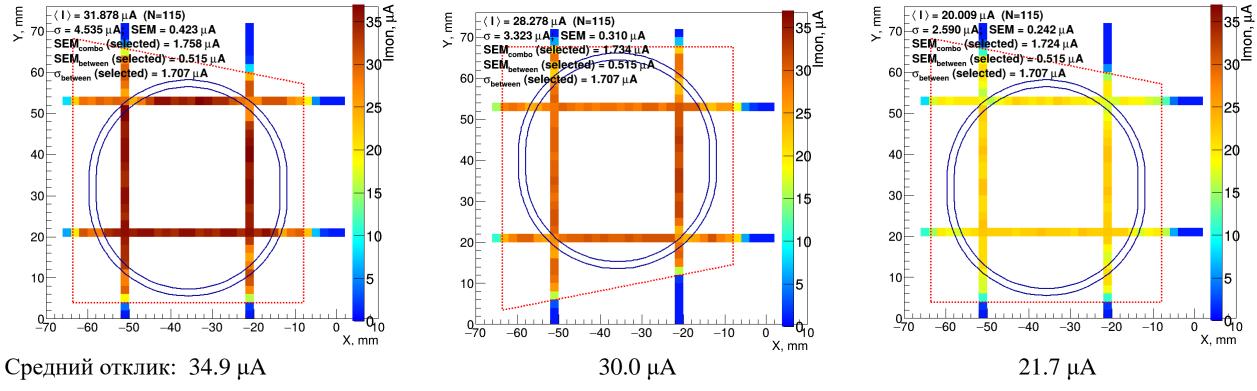


Рис. 5 – Сравнение откликов с тайлов с производственным дефектом (отсутствие светоотражающей краски и клея)

- ➤ Тепловые карты отклика были собраны для двух образцов: с оптическим клеем СКТН Б, без светоотражающего покрытия и без клея средний отклик в центральной области сцинтиллятора отличается на 38%. В случае аномального радиационного повреждения детектора он по прежнему будет выполнять свои функции.
- > Первоначальный метод информативен и точен, однако снятие полной карты занимает слишком много времени
- > Был предложен более быстрый, но менее подробный метод на основе сетки (на этапе разработки)

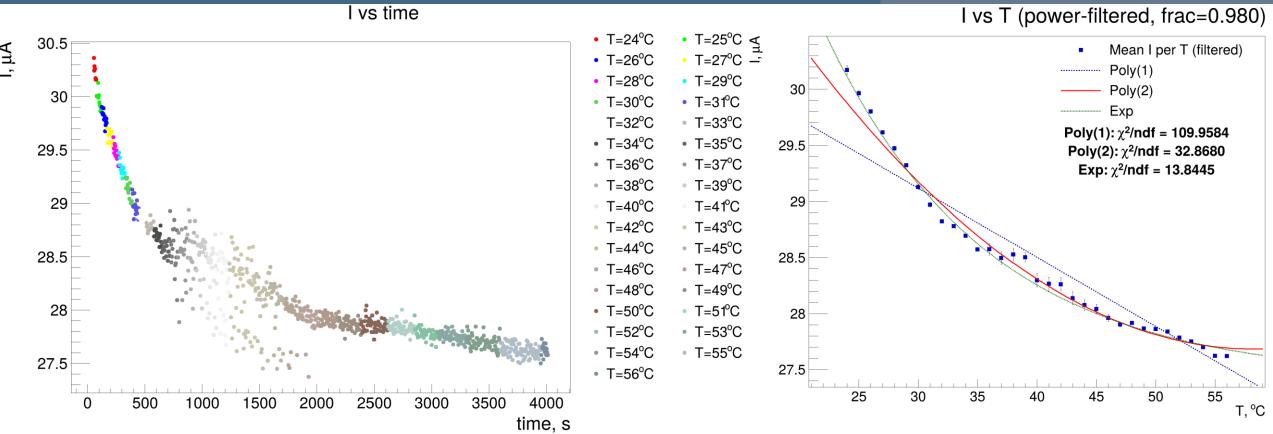


Рис. 6 – Зависимость тока фотоумножителя от времени работы трубки и ее температуры

- > Рентгеновской трубкой облучалась одна точка сцинтиллятора на протяжении часа;
- > Собирались данные по отклику детектора, мощности и температуре трубки
- ▶ Построены распределения зависимости тока фотоумножителя от времени и от температуры (для одной температуры найдено среднее значение отклика + выкинуты значения с дрейфом мощности)
- ➤ За 1 час температура изменилась на 20 °C и ток уменьшился на 3 µA

Зависимость тока SiPM от температуры трубки

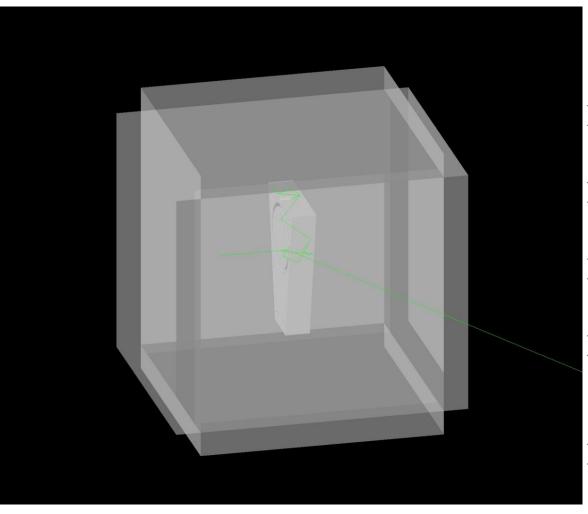
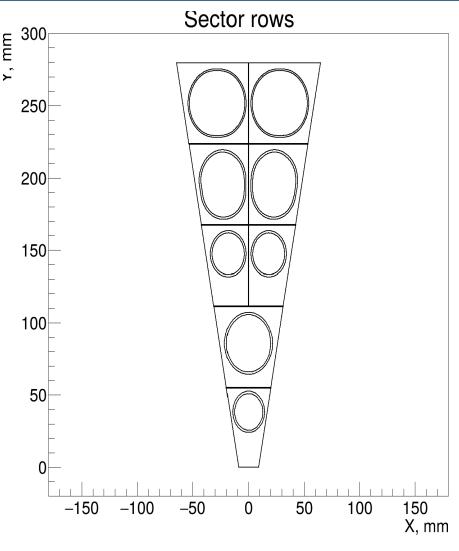


Рис. 7 – Модель тайла в GEANT4, окруженная детекторами

- ➤ В GEANT4 была построена модель сцинтиллятора, облучаемая рентгеновскими квантами (до 22 КэВ, в будущем будет внедрен спектр трубки)
- Многократное перерассеяние убивает локальность облучения
- Сцинтиллятор окружен чувствительными детекторами
- ➤ Задняя панель детектирует 72% квантов, все остальные грани до 13%
- Т.о. около 85% квантов начального потока, несмотря на перерассеяние, покидают детектор и могут быть вторичными источниками
- Этот эффект, в том числе, может вносить наибольший вклад в разность тока центральной и внешней областей

Исследование сектора на сканере



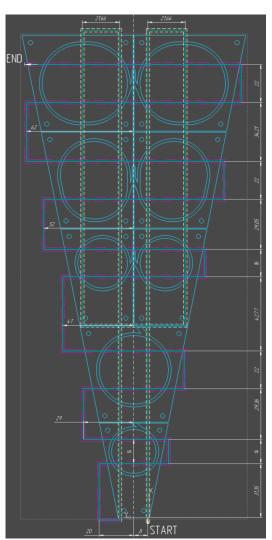


Рис. 7 – Модель сектора в ПО без внедренного ROI и один из контуров обхода

В планах:

- > Сборка сектора (ongoing)
- Учет температурных корреляций
- Проверка наличия перерассеяний из тайла в тайл
- Подавление возможных «обратных» и боковых рассеяний
- Разработка наименее времезатратных методов обхода и сбора сигнала с сектора
- Разработка программного обеспечения (в том числе online)

Разработка платы для 8 и 12 SIPM Hamamatsu

- Разработаны платы для размещения и подключения SIPM Hamamatsu S14160-1310PS на 8 и 12 тайлов с возможностью термокомпенсации температурных отклонений детекторов.
- Подключение реализовано с помощью разъема ВН-30-2.

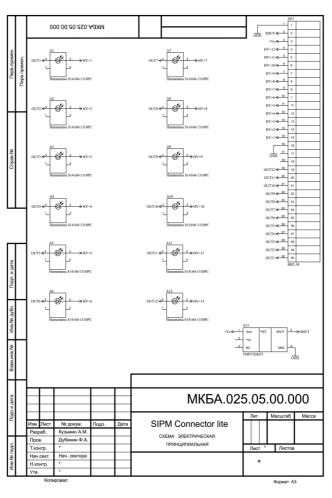


Рис. 8 - Схема принципиальная на 12 тайлов

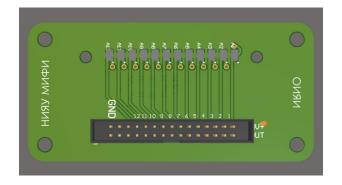


Рис. 9а - Схематическое изображение варианта на 12 тайлов

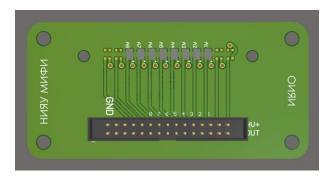


Рис. 9б - Схематическое изображение варианта на 8 тайлов

Термокомпенсация

- Натататы S14160-1310PS весьма чувствительны к изменению рабочей температуры, поэтому для проведения корректных измерений температурные отклонения необходимо учитывать и компенсировать.
- САЕN DT5202 поддерживает 2 типа термодатчиков для внесения температурных поправок: LM94021 и TMP37
- Для реализации на плате был выбран ТМР37 в виду доступности документации и наличия микросхемы в розничной продаже.
- ▶ Исследование CAEN A5251 позволило установить схему подключения термодатчика к FERS.

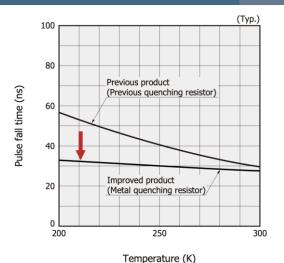


Рис. 10а - Влияние температуры на время среза

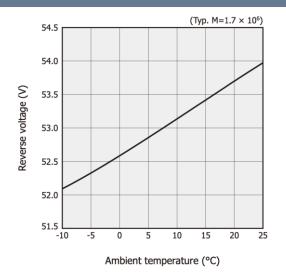
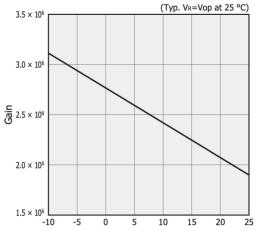


Рис. 10б - Влияние температуры на напряжение



Pис. 10в - Влияние температуры на усиление

More details - @Artem

Расчет тепловыделения

Тепловыделение SIPM Hamamatsu S14160-1310PS - Темновой ток:

$$P_d = 43 \cdot 120 \cdot 10^3 \cdot 1,8 \cdot 10^5 \cdot 1,602 \cdot 10^{-19} = 0,15 \mu W$$
 $typical typical typical gain elementary charge, V count rate, Hz charge, C$

Таким образом, нет потребности в охлаждении SIPM, а основные температурные погрешности вносит среда. Поэтому для внесения поправок достаточно одного термодатчика на плате.

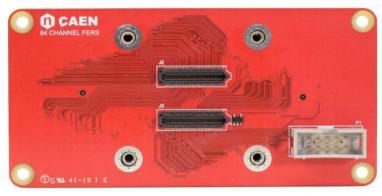


Рис. 11а - Оригинальный модуль CAEN A5251

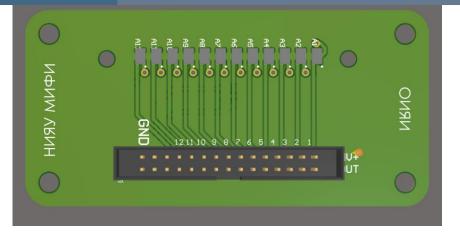


Рис. 11б - Разработанный модуль спереди

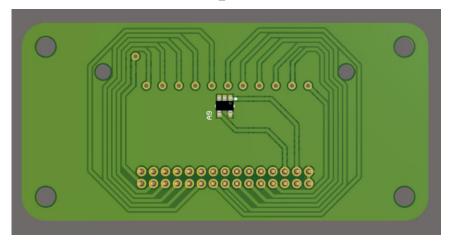


Рис. 11в - Разработанный модуль сзади
More details - @Artem

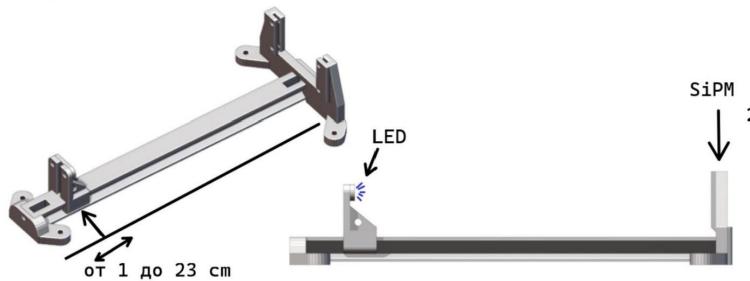
Изготовленые платы на 8 и 12 SIPM Onsemi

Были разработаны и уже изготовлены платы на основе Onsemi MicroFC-10035 в вариантах на 8 и 12 тайлов.

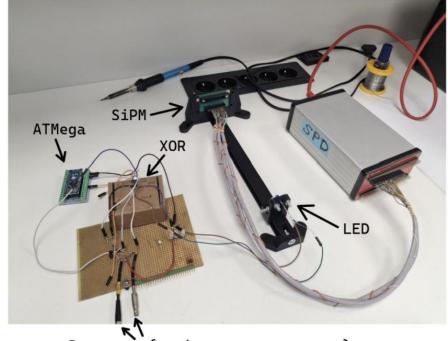


Установка для тестов платы

1. Был разработан стенд для тестирования плат SiPM с возможностью настраивать расстояние от платы до светодиода:



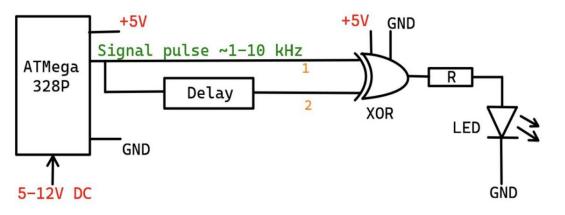
2. Фото установки:



Задержка (на фото не подключена)

Настройка установки для тестов платы

3. Принципиальная схема LED-driver:

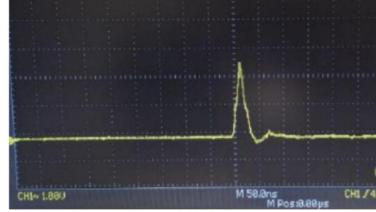


Принцип действия: Получить сигнал нужной длительности и с нужной задержкой возможно с помошью быстродействующей микросхемы Xor. На её входы подаётся раздвоенный сигнал с управляющего пина микроконтроллера; длительность сигнала будет пропорциональна разности задержки сигнала на путях "1" и "2".

4. Промежуточные результаты:

С описанной выше схемой удалось добиться импульсов эффективной длительности порядка 10ns и частоты 1-10 kHz.

*: эффективная длительность меньше полной длительности сигнала, так как у светодиода есть пороговое напряжение, ниже которого он не загорается



Цветовая характеристика	Длина волны	Напряжение
Инфракрасные	от 760 нм	до 1.9 В
Красные	610 - 760 нм	от 1.6 до 2.03 В
Оранжевые	590 - 610 нм	от 2.03 до 2.1 В
Желтые	570 - 590 нм	от 2.1 до 2.2 В
Зеленые	500 - 570 нм	от 2.2 до 3.5 В
Синие	450 - 500 нм	от 2.5 до 3.7 В
Фиолетовые	400 - 450 нм	2.8 до 4 В
Ультрафиолетовые	до 400 нм	от 3.1 до 4.4 В
Белые	Широкий спектр	от 3 ло 3 7 В

Спасибо за внимание!

I vs T (power-filtered, frac=0.980)

